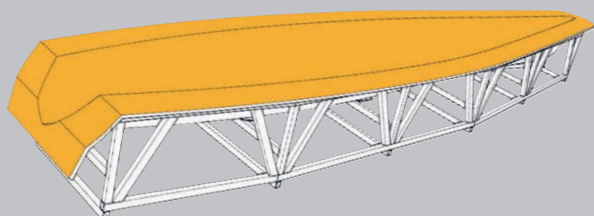




SIKA® COMPOSITES MOULD SYSTEM

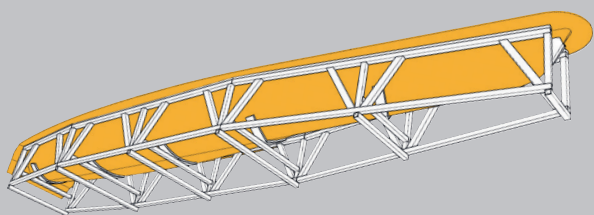
PRODOTTI SIKA® PER LA PRODUZIONE E L'INCOLLAGGIO DI STAMPI IN COMPOSITO



COSTRUZIONE COMPOSITO PER STAMPI FINO A 80 °C

- Sika® Biresin® CR83 + CH83-2/6/10 per infusione o iniezione
- Sika® Biresin® CR82 + CH80-2/6 per laminazione manuale
- Sika® Biresin® S8 gelcoat epossidico - T max di utilizzo 130 °C
- Sika® Stellmittel-T addensante resina

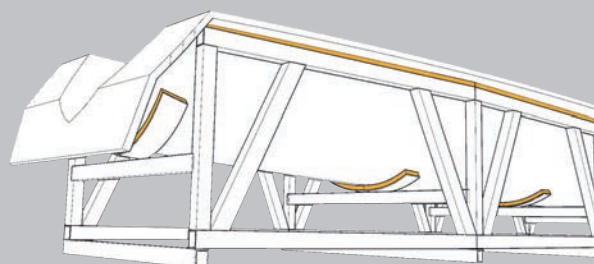
Sistemi epossidici ad elevate caratteristiche meccaniche, Tg di 80 °C circa. Curano a temperatura ambiente. Post-cura a bassa temperatura: 55 - 70 °C.



COSTRUZIONE COMPOSITO PER STAMPI FINO A 110 °C

- Sika® Biresin® CR120 + CH120-3/6 per infusione o iniezione
- Sika® Biresin® CR122 + CH122-3/5 per laminazione manuale
- Sika® Biresin® S8 gelcoat epossidico - T max di utilizzo 130 °C
- Sika® Stellmittel-T addensante resina

Sistemi epossidici ad elevate caratteristiche meccaniche, Tg di 110 °C circa. Curano a temperatura ambiente. Post-cura a bassa temperatura: 55 - 70 - 120 °C.



INCOLLAGGIO TELAIO

- Sikaflex® 252

Adesivo poliuretano strutturale tixotropico monocomponente.

PRODOTTI AUSILIARI

- Sika® Release LG
- Sika® Mold Cleaner
- Sika® Mold Sealer

Sistemi ausiliari per pulizia, impermeabilizzazione e distacco superfici stampo.